

EAC

5000/5100



NVIDIA® Jetson AGX Orin™ 边缘人工智能嵌入式系统

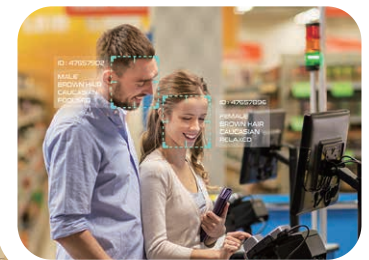


农业机械化



- 领先的NVIDIA® Jetson AGX Orin™平台，支持高达275 TOPS的AI算力
- 最新的 NVIDIA Ampere™架构，采用2048 NVIDIA® CUDA®核心和64个Tensor核心
- 支持8个GMSL 1/2带有Fakra-Z连接器的汽车摄像头
- 1个PCIe Gen3 x8插槽，可支持10GigE/PoE LAN/USB
- 6个千兆网口，其中4个支持PoE+，1个数据显示接口支持4K60
- 2个通道隔离CAN Bus支持灵活的数据传输率，2个RS-232/422/485串口，5个USB 3.1接口
- 支持Allxon远程管理设备
- 9V至50V宽范围直流输入，支持延迟开关机控制

自主移动机器人



智能视频分析



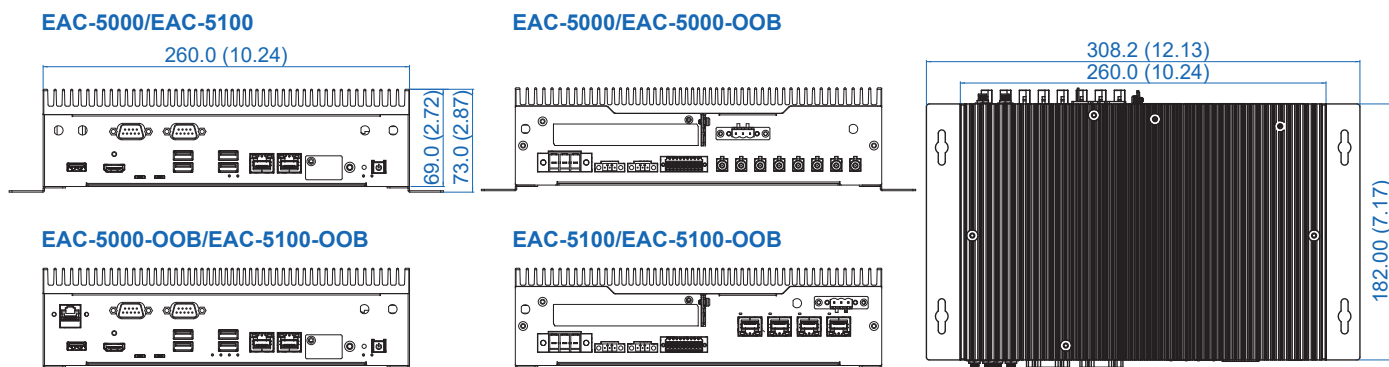
Vecow

规格

系统	
CPU	R32 : 8核Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU R64 : 12核Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU
GPU	R32 : 1792核NVIDIA Ampere™ 架构 · 最多可支持56个Tensor核心 R64 : 2048核NVIDIA Ampere™ 机构 · 最多可支持64个Tensor核心
DL加速器	2x NVDLA深度学习加速器引擎
内存	R32 : 1个32GB LPDDR5内存 R64 : 1个64GB LPDDR5内存
操作系统	- Linux - NVIDIA JetPack SDK
I/O接口	
USB	- 1个USB 3.2 Gen 2 · 可支持10Gbps超高速数据传输 - 4个USB 3.1 · 可支持5Gbps高速数据传输
串口	2个RS-232/422/485串口
CAN Bus	2个通道隔离CAN Bus 支持CAN FD
DIO	16个通道隔离DIO : 8个通道数字输入 · 8通道数字输出
Micro USB	- 1个Micro USB console 接口用于调试 - 1个Micro USB console 接口用于软件更新
按钮	- 1个电源按钮 - 1个恢复按钮 - 1个重置按钮
LED灯号	电源、硬盘、2个用户定义
SIM	2个SIM卡插槽
天线	6个天线支持WiFi/4G/5G/LTE/GPRS/UMTS
扩充接口	
PCIe	1 PCIe x16插槽 PCIe 3.0 x8 信号
M.2	- 1 M.2 Key B 插槽 (3042/3052, USB 3) - 1 M.2 Key E 插槽 (2230, PCIe/USB)
显卡规格	
显示接口	1个数字显示 · 最高分辨率4K60
视频编码	R32 : 1x 4K @60, 3x4K @30, 6x 1080p @60 (HEVC) R64 : 2x 4K @60, 4x4K @30, 8x 1080p @60 (HEVC)
视频解码	R32 : 1x 8K @30, 4x 4K @30, 9x 1080p @60 (HEVC) R64 : 1x 8K @30, 7x 4K @30, 11x 1080p @60 (HEVC)
存储	
M.2	2个M.2 Key M插槽 (2280, PCIe Gen3 x4)
eMMC	1个eMMC 5.1, 64GB
SD	1 Micro SD (外部)
摄像头 (EAC-5000)	
GMSL	8个Fakra-Z连接器 · 用于GMSL 1/2汽车摄像头
以太网	
LAN 1至LAN 2	10/100/1000 Base-T Ethernet GigE LAN, RJ45 接口 (可选 X-coded M12 以太网接口)
PoE (EAC-5100)	
LAN 3至LAN 6	支持IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE, RJ45 接口 (可选 X-coded M12 以太网接口)
电源	
电源输入	9V至50V直流输入
电源接口	3针端子: V+、V-、外壳接地
延迟开关机控制	16个软件模式
远程开关	3针远程交换端子排
频外管理	
MCU	Nuvoton NUC980
接口	OOB LAN, 10/100Mb Ethernet LAN, RJ45 接口
远程管理	支持远程电源开/关 · 重置与电源循环
尺寸&重量	
尺寸	260 mm x 182 mm x 69 mm (10.24" x 7.17" x 2.72")
重量	3.8 kg (8.39 lb)
安装方式	- 壁挂安装 - 导轨和VESA安装(可选)
环境	
工作温度	30W TDP Mode : -25°C至70°C (-13°F至158°F) 40/50W TDP Mode : -25°C至55°C (-13°F至131°F)
储存温度	-40°C至85°C (-40°F至185°F)
冲击测试	Operating, MIL-STD-810G, Method 516.7, Procedure I
摇摆测试	Operating, MIL-STD-810G, Method 514.7, Procedure I, Category 4
EMC	CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2

外观与尺寸

单位：毫米/英寸



采购指南

型号	平台	内存	以太网口	USB 3.1	串口	通道隔离CAN	通道隔离DIO	PCIe插槽	GMSL	PoE+	SIM	M.2	OOB
EAC-5000-R32	Jetson AGX Orin	32GB	2	5	2	2	16	1	8	-	2	4	N
EAC-5000-R64		64GB	2	5	2	2	16	1	8	-	2	4	N
EAC-5000-OOB-R32		32GB	2	5	2	2	16	1	8	-	2	4	Y
EAC-5000-OOB-R64		64GB	2	5	2	2	16	1	8	-	2	4	Y
EAC-5100-R32		32GB	6	5	2	2	16	1	-	4	2	4	N
EAC-5100-R64		64GB	6	5	2	2	16	1	-	4	2	4	N
EAC-5100-OOB-R32	32GB	6	5	2	2	16	1	-	4	2	4	Y	
EAC-5100-OOB-R64	64GB	6	5	2	2	16	1	-	4	2	4	Y	

* All product information may subject to change without prior notice.

* The rights of all brand names, product names and trademarks belong to their respective owners.

Copyright © 2024 Vecow Co., Ltd. All rights reserved.